



2025年7月1日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ェ ロ ー テ ッ ク  
代 表 者 名 代表取締役社長 賀 賢 漢  
(コード番号：6890 東証スタンダード市場)  
問 合 わ せ 先 I R ・ 広 報 部 長 野 田 耕 一  
( 0 3 - 3 2 8 1 - 8 1 8 6 )

**(開示事項の経過) 当社中国部品洗浄事業子会社(FTSVA)のパワー半導体基板製造子会社(FLH)の  
資産取得のための株式及び転換社債発行の許可通知受領のお知らせ**

株式会社フェローテック（代表取締役社長 賀 賢漢、以下「当社」）は、2025年6月27日、中国证券监督管理委员会より、深圳証券取引所創業板上場企業の連結子会社である安徽富樂徳科技發展股份有限公司（以下、「FTSVA」）がパワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社である江蘇富樂華半導体科技股份有限公司（以下、「FLH」）の資産取得のための株式及び転換社債の発行許可に関する通知を受領し、同日深圳証券取引所 Web サイト上に開示されましたのでお知らせします。

本件株式及び転換社債の発行許可に関する情報については、2024年11月26日付け開示「(開示事項の経過) 当社中国部品洗浄事業子会社(FTSVA)によるパワー半導体基板製造子会社(FLH)株式取得に関するお知らせ」の記載も併せてご参照ください。

記

1. 子会社の概要

(1)FTSVA (2025年6月30日現在)

(1)	名 称	安徽富樂徳科技發展股份有限公司 (FTSVA)	
(2)	所 在 地	中国安徽省銅陵市金橋經濟開發区南海路 18 号	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	半導体・FPD 向け高純度プロセスツールパーツ洗浄サービス	
(5)	資 本 金	341,307.6 千中国元 (約 69 億円) (1 中国元=20.19 円)	
(6)	設 立 年 月 日	2017 年 12 月 26 日	
(7)	大株主及び持ち分比率	上海申和投資有限公司 (略称 FTS)	持ち分比率 49.81%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社である FTS が議決権の 49.81%を保有する子会社
		人 的 関 係	当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

(2)FLH (2025年6月30日現在)

(1)	名 称	江蘇富樂華半導体科技股份有限公司 (FLH)	
(2)	所 在 地	中国江蘇省東台市城東新区鴻達路 18 号	
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 賀 賢漢	
(4)	事 業 内 容	パワー半導体用基板の製造、販売	
(5)	資 本 金	417,074 千中国元 (約 84 億円) (1 中国元=20.19 円)	
(6)	設 立 年 月 日	2018 年 3 月 16 日	
(7)	大株主及び持ち分比率	上海申和投資有限公司 (略称 FTS)	持ち分比率 55.11%
(8)	上場会社と当該会社との間の関係	資 本 関 係	当社連結子会社である FTS が議決権の 55.11%を保有する子会社
		人 的 関 係	当社代表取締役社長が当該子会社の董事長を兼任
		取 引 関 係	該当事項はありません

## 2. スケジュール

2024 年 11 月 25 日	FTSVA と FLH 株主 (FTS 等) が、FLH 株式譲渡契約を締結
2024 年 12 月 23 日	FTSVA 株主総会を開催
2025 年 1 月 25 日	深圳証券取引所への申請受理
2025 年 5 月 29 日	深圳証券取引所 M&A・再編審査委員会の審査終了：適合
2025 年 6 月 27 日	中国证券监督管理委员会から株式及び転換社債発行に関する許可通知を受領
2025 年 7 月	新株・転換社債の発行、株式譲渡の発効 (予定)

## 3. 今後の見通し

本件は連結子会社間の株式交換のため、当社グループの今期業績への影響はない見通しです。なお、追加で開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせします。

## 4. 備考

本件に関しては、下記開示についてもあわせてご参照ください。

2025 年 5 月 30 日	(開示事項の経過) 当社中国部品洗浄事業子会社 (FTSVA) によるパワー半導体基板製造子会社 (FLH) の合併審査に関する「適合」通知受領のお知らせ
2025 年 1 月 27 日	「(開示事項の経過) 深セン証券取引所による当社中国部品洗浄事業子会社 (FTSVA) の「重大資産再編に関する申請」の受理に関するお知らせ」
2024 年 11 月 26 日	「(開示事項の経過) 当社中国部品洗浄事業子会社 (FTSVA) によるパワー半導体基板製造子会社 (FLH) 株式取得に関するお知らせ」
2024 年 10 月 16 日	「当社中国部品洗浄事業子会社によるパワー半導体基板製造子会社株式取得の協議開始に関するお知らせ」

この文書は、当社子会社である安徽富樂德科技發展股份有限公司の組織再編へ向けた準備に関して一般に公表するための開示文書であり、一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではなく、またこの文書又はその一部は、中国、日本、米国その他の地域において関連する契約、約束又は投資判断の基礎を成すべき又は依拠されるものではありません。したがって、この文書は、米国を含むいかなる法域においても、株式又は有価証券の募集又は取得勧誘を構成し又は意図するものではありません。米国においては、登録又は登録免除なしに有価証券の募集販売はできません。公募を通じた有価証券の購入は、当該有価証券に関する最終のオファリング・メモランダム又はプロスペクトスに含まれる情報のみを基礎として行われるべきです。現時点において、当社子会社は米国において有価証券の公募を行う意図を有していません。

以 上